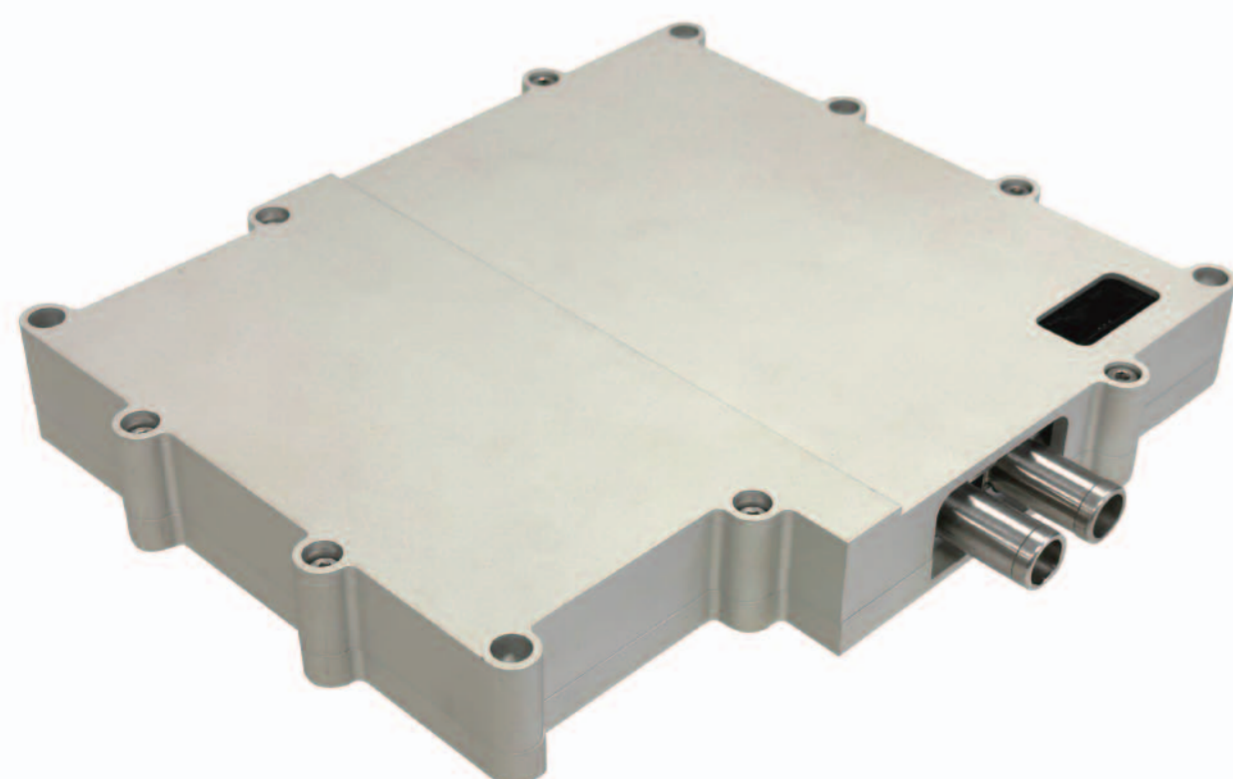


## パワー半導体をプリント配線基板に一体化して実装する基盤技術を開発、これにより小型化を実現

We have developed the foundational technology for mounting power semiconductors integrated into printed circuit boards, thereby achieving miniaturization

### 特長 : Feature

#### 試作品 Prototype



#### 適用 Applications

- **xEV 向け駆動用インバーター**  
Traction inverter for xEV (BEV, PHV)
- **電力変換器**  
Power converter

#### 仕様 Specifications

容積 /Volume	1.5 L
最高出力 /Max output	170 kVA
最高電流 /Max current	350 Arms
出力密度 /Power density	113 kVA/ℓ